

Title (en)

Electronic component, in particular a chip inductance.

Title (de)

Elektronisches Bauteil, insbesondere für eine Chip-Induktivität.

Title (fr)

Composante électronique, en particulier une micro-inductance.

Publication

**EP 0157927 A1 19851016 (DE)**

Application

**EP 84115156 A 19841211**

Priority

DE 3410811 A 19840323

Abstract (en)

[origin: US4717901A] An electronic component includes a solid core part having a perpendicular prismatic spatial shape and lateral surfaces, the core part having a recess in the form of a blind hole formed therein defining a winding space, and electrical contact layers disposed on at least some of the lateral surfaces of the core part.

Abstract (de)

Elektronisches Bauteil für eine Chip-Induktivität, insbesondere HF-Drossel, mit einem massiven Kernteil (1) bestehend aus ferromagnetischem oder elektrisch nicht leitendem Werkstoff, insbesondere Ferrit, Keramik oder Kunststoff, mit einer sacklochartigen oder hohlzylindrischen, als Wickelraum dienenden Aussparung (2), die über randoffene Kanäle (4, 5) mit elektrischen Kontaktflächen (3) an bevorzugt getrennten Seitenflächen des Kernteils (1) verbunden ist.

IPC 1-7

**H01F 17/04**; **H01F 17/02**; **H01F 15/10**

IPC 8 full level

**H01F 17/02** (2006.01); **H01F 17/04** (2006.01); **H01F 27/29** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**H01F 17/02** (2013.01 - EP US); **H01F 17/04** (2013.01 - EP US); **H01F 27/292** (2013.01 - EP US); **H01F 2017/048** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [X] EP 0025605 A1 19810325 - TDK CORP [JP]
- [A] US 3585553 A 19710615 - MUCKELROY WILLIAM L, et al
- [A] US 3287678 A 19661122 - TAKASHI OKAMOTO, et al
- [A] GB 567963 A 19450309 - NEOSID LTD, et al
- [A] GB 1055808 A 19670118 - COLE E K LTD
- [AD] DE 3225782 A1 19830210 - TDK ELECTRONICS CO LTD [JP]

Cited by

DE3817890A1; CN112002515A; WO9720327A1; US6169470B1

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB NL

DOCDB simple family (publication)

**EP 0157927 A1 19851016**; **EP 0157927 B1 19890322**; DE 3477438 D1 19890427; JP H0449763 B2 19920812; JP S60214510 A 19851026; US 4717901 A 19880105

DOCDB simple family (application)

**EP 84115156 A 19841211**; DE 3477438 T 19841211; JP 5767785 A 19850322; US 3519187 A 19870406